



Communiqué de presse
20 janvier 2010

OSEO attribue une aide de plus de 21 M€ au projet PRIIM
(Projet de Réalisation et d'Innovation Industrielle dédié aux Microsystèmes hétérogènes)

OSEO soutient le projet PRIIM qui vise la création d'une offre industrielle conjointe de composants passifs intégrés (IPD) sur silicium et de technologies de packaging avancés pour la miniaturisation (SiP : System in Package), ouverte et indépendante des grands fondeurs. Ces technologies permettent le développement de sous-ensembles électroniques hyperminiaturisés d'importance croissante dans les domaines tels que l'aérospatial et la défense, mais aussi le médical et le paramédical, l'automobile, les télécommunications, la cartes à puce ou la domotique...

Le projet inclut à la fois l'étude des technologies et procédés innovants pour la réalisation de circuits multicomposants compacts incluant des calculateurs, des passifs, de la mémoire, des capteurs et actionneurs, et le développement de plusieurs applications innovantes qui en bénéficient directement.

Le projet PRIIM est coordonné par IPDiA, expert dans la fabrication de composants passifs intégrés sur silicium situé à Caen. Il est réalisé en partenariat avec 3D PLUS, entreprise reconnue pour l'assemblage 3D de puces électroniques, ELA MEDICAL (Sorin Group) pour de nouveaux implants médicaux, MOVEA pour des capteurs de mouvements corporels miniaturisés, KALRAY pour les matrices intégrées de processeurs massivement parallèles pour les systèmes embarqués et GEMALTO pour les cartes à puce multifonctionnelles. Les centres de recherche CEA LETI, CNRS LAAS et CNRS CRISMAT sont au cœur de ce projet pour lever les divers verrous technologiques préalables à la réalisation de microcomposants hétérogènes performants.

Le projet de R&D sera financé par le programme Innovation Stratégique Industrielle (ISI) d'OSEO à hauteur de 21,2 millions d'euros sur 4 ans. L'aide d'OSEO se compose d'une subvention de 12,9 millions d'euros et d'une avance remboursable de 8,3 millions d'euros.

PRIIM doit permettre à la fois de renforcer la filière industrielle microélectronique européenne et nationale, en offrant aux équipementiers, en particulier les PME, des solutions adaptées pour la réalisation de microcircuits multifonctions hétérogènes en petites et moyennes séries, d'en faire bénéficier très tôt plusieurs applications critiques en termes de volume et de performance, et d'offrir des débouchés industriels supplémentaires aux nombreuses innovations présentes et futures issues des meilleurs laboratoires publics.

A propos du Programme « Innovation Stratégique Industrielle » d'OSEO

Le programme « Innovation Stratégique Industrielle » (ISI) favorise l'émergence de champions européens. Il soutient des projets ambitieux d'innovation collaborative à finalité industrielle, portés par des entreprises de taille intermédiaire (moins de 5000 collaborateurs) et des PME (moins de 250), toutes innovantes. Ces projets sont très prometteurs en cas de succès : ils visent à commercialiser les produits de ruptures technologiques et ne pourraient se réaliser sans incitation publique. L'aide est d'un montant généralement compris entre 3 à 10 M€, sous la forme de subventions et d'avances remboursables.

Contact Presse :

Sabina Cristova
Tél : 01 41 79 98 85
Mail : sabina.cristova@oseo.fr

Vanessa Godet
Tél : 01 41 79 84 33
Mail : vanessa.godet@oseo.fr